

主催：岩手大学分子接合技術研究センター  
共催：i-SB事業化プラットフォーム  
(運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター)  
後援：INSポリマー研究会、東北ポリマー懇話会

日時：2024年

3月8日(金)

13:00-17:00

# 次世代高速通信に 対応した 高周波基板材料に 関するセミナー

会場：  
盛岡市産学官連携研究センター  
(コラボMIU/岩手大学理工学部構内)

オンライン  
配信あり  
(Zoom)

岩手大学分子接合技術研究センターは、i-SB事業化プラットフォーム運営主体の中核組織として、分子接合技術(i-SB法®)と樹脂精密設計技術のものづくり分野における幅広い普及と、それによるプロセスとプロダクトのイノベーション創出を目指す活動を展開しています。

このたび、当センターでは、Beyond 5Gに向けた高周波基板材料に関するセミナーを開催します。

◆参加費：10,000円  
(消費税込・資料付き)

◆申込：  
下記URLまたはQRコードを読み込んで  
お申し込み下さい。

<https://forms.gle/QWWj73u922ZSjmaU9>

申込期限

2月29日(木)



◆定員：40名

- ・参加費は事前振込となります。振込先は、お申し込みを受け付けた後、メールでご案内いたします。
- ・オンライン (Zoom) 参加者には、セミナー前日にミーティングリンクを送付します。

◆プログラム：

1.

マイクロエレクトロニクス実装材  
最新技術動向

(60分)

デクセリアルズ株式会社 コーポレートR&D本部  
先端材料デバイス技術開発部 担当部長 林 直樹 氏

2.

次世代BTレジン積層材料の開発動  
向と低伝送損失化

(60分)

三菱ガス化学株式会社 研究統括部 東京研究所  
主任研究員 小林 宇志 氏

3.

先端パッケージ向けポリイミド材料

(60分)

東レ株式会社 電子情報材料研究所  
主任研究員 荒木 育 氏

4.

トリアジン含有樹脂の低誘電化

(60分)

岩手大学 理工学部 教授 大石 好行

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局 (岩手大学 研究・地域連携課)

✉ [isb-office@iwate-u.ac.jp](mailto:isb-office@iwate-u.ac.jp)



[https://www.cord.iwate-u.ac.jp/ecosystem\\_news/eco\\_info/6577/](https://www.cord.iwate-u.ac.jp/ecosystem_news/eco_info/6577/)